حامل النقش عالي النقاء من Ptfe لحامل كاسيت الرقائق لتنظيف رقائق السيليكون وأمثلية مقاومة الأحماض

رقم العنصر: PL-CP09

مقدمة

كاسيتات رقائق PTFE عالية الجودة مصممة لنقش وتنظيف أشباه الموصلات. تضمن مقاومة فائقة لـ HF وبناء عالي النقاء معالجة آمنة لرقائق السيليكون في عمليات الرطب الحرجة. مثالية للرقائق من 2 بوصة إلى 12 بوصة في بيئات الغرف النظيفة.

اعرف المزيد

التطبيق	الوصف	الفائدة الرئيسية
النقش بحمض الهيدروفلوريك	غمر رقائق السيليكون في حمض الهيدروفلوريك لإزالة الأكاسيد الأصلية أو الطبقات التضحية.	المقاومة الكاملة لـ HF تضمن عدم تدهور المادة أو تلوثها.
تنظيف RCA	تنظيف متعدد الخطوات قياسي (SC-1 و SC-2) يتضمن بيروكسيد الهيدروجين وهيدروكسيد الأمونيوم.	يمنع PTFE عالي النقاء إعادة ترسيب الأيونات المعدنية على أسطح الرقائق.
تصنيع الخلايا الشمسية	معالجة رقائق السيليكون أثناء خطوات التنظيف الخاصة بالتكوين النسيجي وانتشار الفوسفور.	يدعم التصميم القوي الإنتاجية العالية في التصنيع الشمسي الصناعي.
أشباه الموصلات المركبة	معالجة رقائق GaAs و GaN و SiC للإلكترونيات القوية وتطبيقات الترددات الراديوية (RF).	يمنع تصميم الفتحات التلطيخ تلف الرقائق عالية القيمة الهشة.
التصوير الضوئي	دعم الرقائق أثناء عمليات تطوير وإزالة الطلاء الضوئي باستخدام المذيبات العضوية.	يمنع البناء المقاوم للمذيبات انتفاخ أو تليين الحامل.
الشطف بعد التلميع الكيميائي الميكانيكي (CMP)	شطف عالي النقاء للرقائق بعد التلميع الكيميائي الميكانيكي لإزالة جسيمات المعلق.	تسهل الأسطح الناعمة الإزالة الكاملة للجسيمات الكاشطة أثناء الشطف.
تصنيع أنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS)	معالجة حرجة لأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة أثناء التحضير للنقش الأيوني التفاعلي العميق (DRIE).	يحافظ التفتيت الدقيق على المحاذاة للرقائق ذات البنية الدقيقة المعقدة.
التنظيف بالموجات فوق الصوتية	الاستخدام في خزانات الموجات فوق الصوتية أو الميجاسونيك لإزالة المواد الجسيمية الدقيقة من الرقائق.	تخفف المادة الاهتزازات بشكل فعال مع مقاومة تلف التجويف.

المعامل	تفاصيل المواصفات لـ PL-CP09
سلسلة الموديل	PL-CP09 (كاسيتات قياسية ومخصصة)
المادة	PTFE أولي عالي النقاء (بولي تترافلورو إيثيلين)
توافق حجم الرقاقة	1 بوصة، 2 بوصة، 3 بوصة، 3.5 بوصة، 4 بوصة، 4.5 بوصة، 5 بوصة، 6 بوصة، 8 بوصة، 12 بوصة
أنماط التكوين	حامل رقاقة فردي، كاسيت متعدد الرقائق، تخطيطات مخصصة
سعة الفتحة (فردي)	1-5 رقائق (متاحة للأحجام حتى 12 بوصة)
سعة الفتحة (متعدد)	تكوينات قياسية 25 فتحة أو مخصصة عالية الكثافة
درجة حرارة التشغيل	من -200 درجة مئوية إلى +260 درجة مئوية (من -328 درجة فهرنهايت إلى +500 درجة فهرنهايت)
المقاومة الكيميائية	جميع الأحماض والقواعد والمذيبات الشائعة (باستثناء المعادن القلوية المنصهرة)

التطبيق	الوصف	الفائدة الرئيسية	
المعامل	تفاصيل المواصفات لـ PL-CP09		
حجم الرقاقة	نوع الحامل	عدد الفتحات القياسي	توفر التخصيص
عملية التصنيع	تشغيل آلي كامل بالكمبيوتر (CNC) (خالي من ملوثات قولبة الحقن)		
خيارات المقبض	مقبض رأسي فردي، مقابض جانبية مزدوجة، أو واجهات آلية مخصصة		
تشطيب السطح	خشونة سطحية (Ra) أقل من 0.8 ميكرومتر (تشطيب عالي اللمعان متوفر عند الطلب)		

حجم الرقاقة	نوع الحامل	عدد الفتحات القياسي	توفر التخصيص
1 بوصة / 2 بوصة	فردي/متعدد	1، 5، 10، 25	قابل للتخصيص بالكامل
3 بوصة / 3.5 بوصة	فردي/متعدد	1، 5، 25	قابل للتخصيص بالكامل
4 بوصة / 4.5 بوصة	متعدد الرقائق	25	تعديلات في المقبض والمسافة بين الفتحات
5 بوصة / 6 بوصة	متعدد الرقائق	25	تعديلات في المقبض والمسافة بين الفتحات
8 بوصة / 12 بوصة	متعدد الرقائق	13، 25	تخصيص عالي الدقة